PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-279014

(43)Date of publication of application: 10.10.2001

(51)Int.CI.

C08J 9/14 CO8K 3/24 CO8L 25/04 H01B 3/00 H01B 3/44

(21)Application number: 2000-098658

(71)Applicant:

ACHILLES CORP

(22)Date of filing:

31.03.2000

(72)Inventor:

NAKAYAMA NAOKI

(54) DIELECTRIC EXPANSION-MOLDED PRODUCT HAVING IMPROVED DIMENSIONAL STABILITY

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a lightweight composite dielectric foam having dimensional stability as a dielectric material for an antenna, a laser reflector, etc., and having a small change of dielectric constant accompanied with a temperature change. SOLUTION: This dielectric expansion-molded product is obtained by substantially uniformly dispersing a dielectric ceramic into a foam composed of a styrenic base material preferably in an amount of 5-50 wt.% based on the total amount with the base resin, is characterized by having 1.0-2.0 dielectric constant, ≤0.005 dielectric loss tangent and 0.3-0.04 g/cm3 bulk specific gravity. including a residual foaming agent therein in an amount of ≤3 wt.% and having -0.5 to 0% rate of dimensional change as compared with the previous state when left in an oven at 50° C for 100 days and has dimensional stability. The styrenic base resin preferably contains a polyolefin resin having a low molecular weight in an amount of 0.1-10 pts.wt. based on the total amount thereof.



(19) 日本国特許庁 (JP). ·

(12)公開特許公報 (A)

(II)特許出願公開番号 特開2001-279014

(P2001-279014A) (43)公開日 平成13年10月10日(2001.10.10)

| (51) Int. Cl. 7 | 識別記号 | FΙ | | | テーマコー | ' (参考 | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|---------|-------|--|
| C08J 9/14 | CET | CO8J 9/14 | 1 (| CET | 4F074 | | |
| C08K 3/24 | | CO8K 3/24 | 1 | | 41002 | | |
| COSL 25/04 | | CO8L 25/04 | 1 | 5G303 A 5G305 | | | |
| H01B 3/00 | | H01B 3/00 |) | | | | |
| 3/44 | | 3/44 | 1 | | K | | |
| | 審查請 | 求 未請求 請求 | 項の数4 O | L (全 | 13頁) 最終 | 頁に続く | |
| (21)出願番号 | 特顧2000-98658(P2000-98658) | (71)出願人 | 000000077 | | | | |
| | | | アキレス株式 | 式会社 | | | |
| (22)出願日 | 平成12年3月31日(2000.3.31) 東京都新宿区大京町22番地 | | | | 2番地の 5 | | |
| | | (72)発明者 | 中山 直樹 | | | | |
| | • | | 栃木県足利市 | 市五十部町 | T878— 8 | | |
| | | (74)代理人 | 100068618 | | | | |
| • | | | 弁理士 萼 | 経夫 | (外3名) | | |
| | | . | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | r describação | | | | | |
| | | | | | 最終 | 頁に続く | |

(54) 【発明の名称】改良された寸法安定性を有する誘電発泡成形品

(57)【要約】

【課題】アンテナ、レーザー反射器等用の誘電体材料として寸法安定性をもち、温度変化による比誘電率の変化の小さい、軽量な、複合誘電発泡体を提供する。

【解決手段】スチレン系基材樹脂よりなる発泡体に誘電体セラミックスが好ましくは該基材樹脂との合計量に基づき5~50重量%の量で、実質的に均一に分散されている誘電発泡成形品であって、該発泡成形品の比誘電率は1.0~2.0であり、誘電正接は0.005以下であり、結比重は0.3~0.04g/cm³であり、該発泡成形品に残存している発泡剤の量が3重量%以下で、かつ該発泡成形品を50℃のオーブン中に100日間放置したときの該発泡成形品の寸法変化率は、放置前と比較して−0.5%~0%であることを特徴とする寸法安定性を有する誘電発泡成形品。上記スチレン系基材樹脂は、低分子量のボリオレフィン樹脂を該基材樹脂の総量に基づいて0.1~10重量部含むものが好ましい。

【開求項1】 スチレン系基材樹脂よりなる発泡体に誘電体セラミックスが実質的に均一に分散されている誘電発泡成形品であって、該発泡成形品の比誘電率は1.0 乃至2.0の範囲の値を有し、誘電正接は0.005以下の値を示し、そして嵩比重は0.3乃至0.04g/cm³の値であり、さらに該発泡成形品に残存している発泡剤の量が3重量%以下であり、かつ、該発泡成形品を50℃のオーブン中に100日間放置したときの該発泡成形品の寸法変化率は、放置前と比較して-0.5% 10乃至0%であることを特徴とする寸法安定性を有する誘電発泡成形品。

1

【請求項2】 低分子量のポリオレフィン樹脂を前記スチレン系基材樹脂の総量に基づいて0.1乃至10重量部含むことを特徴とする請求項1記載の誘電発泡成形品。

【請求項3】 前記低分子量のポリオレフィン樹脂は、 重量平均分子量500乃至1000の低分子量ポリエ チレンであり、融点が100乃至130℃であることを 特徴とする請求項2記載の誘電発泡成形品。

【請求項4】 発泡体中に分散された前記誘電体セラミックスは主に粉末状またはウィスカー状のものより成り、かつ、該誘電体セラミックスの含有量は前記スチレン系基材樹脂および該誘電体セラミックスの合計量に基づいて5乃至50重量%であることを特徴とする請求項1記載の誘電発泡成形品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発泡誘電材料からなる改良された寸法安定性を有する誘電発泡成形品に関する。また、本発明は誘電体として使用できる発泡成形品、特にルーネベルクレンズの原理を利用した球状型誘電体レンズを構成する各層の誘電材料に使用することができる優れた寸法安定性をもつ発泡成形品を提供するものである。

[0002]

【従来の技術】ルーネベルクレンズの原理を利用した球状型誘電体レンズは、古くから知られており、その特性からレーダー電波反射器、アンテナ等に利用されている。特公昭43-27061号公報には、この種の誘電 40体の構造体に関する開示がある。この公報において、球状型誘電体レンズの理想的な形は、球体の中心部の比誘電率が2.0と言われており、それより外側に向かうにつれて比誘電率が低下していき、最外層の表皮部では1.0になる様に連続的に比誘電率が変化する球体であることが教示されている。しかし、実際にこの様に連続的に比誘電率が変化する球体を作製することは、製造上の困難と多大な費用を伴うため、通常は、比誘電率の異なる複数(5乃至15層)の球状の誘電体を同心の中心部から外側に向かって層状に積み重ねた構造を球状型誘 50

電体レンズとしている。すなわち、最外郭層の比誘電率 を1. 0近くにし、その後、内層に向かうに従って比誘 電率を高くしていき、中心部のコア層は2.0近くの比 誘電率とする構造をもつ球体として製造されている。球 状型誘電体レンズのための誘電材料として比誘電率の値 は重要であるがさらにその性能を左右する大事な特性と して、誘電正接(t an δ) の数値がある。これは、誘 電損失を表す指標になるが、比誘電率が所望する1.0 乃至2.0の範囲に入っていたとしても、この誘電正接 が大きいと該材料における比誘電率の損失(ロス)が大 きく発生してしまう為、レーダー反射器またはアンテナ としての性能が十分に発揮できなくなる。従って、この 誘電正接(tanδ)の値は、0.005以下にする必 要がある。加えて、これらの誘電材料からなる多層の成 形体の容積が大きくなると運搬や、さらにこれを設置す るのにも、多大な労力と費用がかかるため、該誘電材料 は軽量であること、即ち比重が小さいことが望ましい。 【0003】ところで、誘電体材料として、ボリスチレ ンが低い誘電正接を有する誘電体材料であることは知ら れている。ボリスチレンは、未発泡の状態で60Hzで 測定した比誘電率が2.5前後でありまた誘電正接は 0.0002前後と低い値を保持している。したがって このポリスチレンを適宜発泡することにより、その嵩比 重差に従って、2.5前後以下の比誘電率を有する発泡 体を調製することは可能である。しかし、比誘電率1. 0乃至2. 0を達成しようとした場合、特に比誘電率 1. 5以上の部分を得るには、嵩比重を 0. 4前後以上 にしなければならず、軽量でなくなってしまう。このた めポリスチレンの誘電特性を利用しつつ軽量化を図るた めに他の誘電特性を有する材料を混合する必要がある。 【0004】そこで、誘電体材料としてのポリスチレン の性質を利用して、改良した誘電材料を提供するべく、 従来技術において幾つかの提案や試みがなされてきた。 それらは例えば以下に示すものである:

1) 特公昭56-38003号公報においてはプラスチ ック誘電体に平均粒径0.1mmないし1.0mm程度 のアルミニウム金属粒を入れてなる複合誘電体材料が開 示されている。この公報の実施例においてはプラスチッ ク誘電材料として、比重0. 117g/cm の発泡ポリス チロールを用い、これに直径約0.5乃至1.0mの高 純度アルミニウム粒子を適量混合した後、酢酸ビニルボ リマーをパインダーとしてこれらを成形体にしている。 しかしこの場合、比重の軽い発泡ポリスチロールと比重 の重いアルミニウム粒子とを均一に混合することは極め て難しく、成形体とした時に成形体の内部において、比 重のバラツキ、アルミニウムの濃度バラツキが生じてし まう。また、酢酸ビニルボリマーをバインダーとしてい るが、この量が少ないと、接着が不十分となり成形体は 極めて脆い物となるし、また多いと、成形体とした場合 の比誘電率を上げる作用が減少することから、そのバイ

٠.

ンダーの配合量の調節が難しい。また、この実施例か ら、比誘電率が2を得る為の比重としては、0.3g/cm '以上が必要となっている。

2) 特公昭60-52528号公報では発泡プラスチッ ク粒またはガラスバルーン、シラスバルーンなどの無機 質中空体粒とこれらの表面を金属の薄膜で覆った金属被 膜粒とを所望の比誘電率が得られるように適切な混合比 で混合してなる混合誘電体材料が開示されている。この 公報における実施例では、20乃至30倍に発泡したブ ラスチック粒子に、発泡プラスチック粒子の表面を蒸着 10 などの方法で鍋、アルミニウムなどの金属の薄膜で覆っ た金属被膜粒子を適宜混合し、熱発泡して成形する方法 である。この文献では上記1)の特公昭56-3800 3号公報に見られる比重の異なる誘導体を混合するため に生じる不均一な混合および比誘電率を上げることによ って比重も大きくなる問題を解決しているが、新たな問 題が生じている。すなわち、熱成形とは、水蒸気等によ る熱で型内にある樹脂粒子を相互に熱融着することであ るが、表面を金属の薄膜で覆われた金属被膜粒子には、 もちろん熱融着性はなく、成形することはできない。従 20 って、比誘電率を上げるために金属被膜粒子の混合割合 を増やしていくと、成形体の融着性は急激に低下し強度 物性の弱い実用に耐えられない物となってしまうのであ る。さらに、発泡プラスチック粒子の表面を金属で蒸着 する場合には、多大な労力と費用がかかり現実的ではな 64

3) 特公昭61-21147号公報においては発泡性樹 脂と親和性がありかつ界面活性剤を含有する樹脂で金属 箔の片面ないし両面を被覆した金属箔フレークを発泡性 樹脂に混合してなる誘電体材料が開示されている。そし 30 て、具体的な記載において、ある条件のもとで表面処理 した金属箔フレークを発泡ボリスチレンと押出機内部で 混練りし、ストランドとした後栽断してペレットとして いる。この方法によれば、複合材料を均質に混合できな いこと、比誘電率を上げると比重が大きくなることおよ び成形時に金属離脱が生ずるといった先の2つの公報に 示された誘電体材料の欠点は解消するが、金属箱フレー クを使用している為、誘電正接が高くなる。また、この 文献において得られた発泡性誘電体の性能として、実施 例の中に発泡体の比誘電率と比重の関係が開示されてい 40 るが、いずれの発泡体の比重も0.3以上であり、全て 髙密度であることが分かる。従って、従来技術では実用 的で十分な性能を持った誘電体材料を得ることができな かった。

【0005】さらに、レーダー電波反射器、アンテナと して利用されるルーネベルクレンズの原理を利用した球 状誘電体レンズは、その多くが屋外で長期に渡り使用さ れることを想定しなければならない。従って使用期間中 における季節による温度変化の中で、これらの使用条件 を考慮した温度範囲において、比誘電率の変化が小さく 50 含有したボリエチレン-スチレン共重合樹脂を加熱して

なければ、安定した性能を保持することができない。こ のためこれらを構成する誘電体は長期に渡る寸法安定性 能が要求される。また、球状型誘電体レンズを構成する 比誘電率の異なる、5ないし15層の各誘電体層の問 は、十分良く密着されていなければならない。なぜなら ば、各層の間に隙間(空気層)が生じると、各層と層の 間に比誘電率が1.0である空気の層が入り込むことと なり、ルーネベルグレンズ自体の性能が失われてしまう からである。従って、このような球状型誘電体レンズに とって各層ごとの寸法精度ならびに寸法安定性は非常に 重要であり、特に長期間に渡って一定の寸法が安定して 保持できなくてはならない。

4

【0006】また、スチレン系樹脂発泡成形品の寸法安 定性に関しても、従来、幾つかの提案や試みがなされて きた。例えば以下に示すようなものである。

4) 特公昭61-11183号公報は、発泡ボリスチレ ン成形品を常圧または減圧下で数時間以上加熱して、前 記成形品中の発泡剤ガス圧を大気圧と平衡させることに より、前記成形品の寸法を強制的に所望の寸法の近傍ま で収縮せしめることを特徴とする発泡ボリスチレンの寸 法安定化方法を開示する。この公報の記載内容に従え ば、得られた成形品を成形後45~70℃の大気中で2 ~24時間放置するか、または減圧下、室温~65℃で 2~24時間放置する処理が必要となる。しかし、この 方法を実際に生産工場で使用する場合を想定すると、こ れらの乾燥を行うには、新たに乾燥設備を作り、その中 に成形品を逐次入れていかなければならないので作業が 煩雑である。さらに、発泡ポリスチレンの発泡剤として は、通常、ブタン、ペンタン等の可燃性のガスが使用さ れるが、この加熱乾燥中にこれらの発泡ガスが逃げるた め、この乾燥設備には高度の防爆性が要求される。従っ て、乾燥設備の導入には莫大な設備費がかかり、現実的 ではない。

5) また、特開昭61-207448号公報には芳香族 ピニル系単量体とこれと共重合可能な多官能性単量体と で構成され、かつゲル含有率が30重量%以上である共 重合体の発泡成形品(発泡倍率3~15倍)が開示され ている。この公報では、寸法安定性能の評価として、成 形後7日目の寸法変化率と、成形後90日目の成形品の 変化率を求め、経時による寸法変化率をこの両者の差で 表している。従って、経時変化の観測期間としては90 -7=83日間であり、室温(19~20℃)における この期間における寸法変化データを取っているに過ぎな い。しかし、通常球状誘電体レンズとして発泡成形品が 使用される場合、その使用期間は1年以上の長い期間で あって、該発泡成形品の長期に渡る経時寸法安定性の評 価が特に重要であるが、この公報には上記期間よりも長 期に渡る評価データは与えられていない。

6) 特公平4-38222号公報は、易揮発性発泡剤を

予備発泡した発泡粒子を、室温で2~14日放置した 後、型内に充填し、加熱成形して発泡成形品を得て、4 0~60℃の温度下で4時間以上、好ましくは8時間以 上該発泡成形品を熟成する製造方法を開示する。この公 報では、ポリエチレンースチレン共重合樹脂を使用して いるため、発泡成形品内に残存している発泡剤や溶剤が 容易に逸散し、発泡成形品の寸法が安定するとしてい る。しかし、この公報においては、予備発泡粒子を2~ 14日(実施例では1週間) 放置する方法が取られ、さ らにまた、成形品を乾燥室中で熟成する必要がある。通 10 常、予備発泡粒子の熟成期間は8時間乃至1日程度であ るが、このように予備発泡後1週間(実施例)も放置し ておくことは、専用のホッパー(予備発泡粒子を入れて おく通気性のある袋)内において予備発泡粒子を1週間 もの間そのまま保存することになり、その間は該ホッパ ーは使用できないので、生産上極めて効率が悪い。加え てまた、成形品を乾燥するには、上記特公昭61-11 183号公報の場合と同様に特殊な設備を必要とする問 題が生じる。さらに、この特公平4-38222号公報 に記載される寸法安定性の評価においては、室温におけ る6か月経時のデータを示しているが、この間の寸法変 化率は、0.5乃至1.2%(実施例)と比較的大き く、球状型誘電体レンズのように精緻な寸法安定性が要 求される分野には適していない。従って、誘電体材料と して所望の性質をもつと同時に、寸法安定性能の優れた 誘電体材料は未だなお、得られていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の課題 は、上記従来技術に示されるような誘電材料では得るこ とのできなかった、高い比誘電率、低い誘電正接をも ち、軽量で、かつ長期に渡って寸法安定性を有する発泡 成形品を得るところにある。本発明者は誘電体材料とし て、ボリスチレンが優れた比誘電率および極めて低い誘 電正接を有すること、ならびにその発泡性能に着目し、 引き続き、その特性を利用してすぐれた誘電体材料を得 るべく検討した。即ち、本発明の課題はスチレン系樹脂 を基材とする発泡体よりなり、

- 1) 長期に渡ってきわめて高い寸法安定性を有する;
- 2) 温度変化に対して比誘電率の変化量が小さい;
- 3) 比誘電率が1.0万至2.0の範囲内において、誘 40 電正接が0.005以下である;ならびに、
- 4) 軽量である;という条件を満たすところの、ルーネ ベルクレンズの原理を利用した球状型誘電体レンズのよ うな用途に適当な誘電体材料を得ることである。

【0008】本発明者は、まず、上記課題である誘電体 材料として、軽量で、かつ比誘電率が1.0乃至2.0 の範囲内において、誘電正接が0.005以下であるス チレン系樹脂発泡体について検討した。ここで単に誘電 材料としてのポリスチレンの比誘電率を高くする場合に は、上述した引用文献のように高分子材料に金属粉、金 50

風箔(アルミフレーク)等を使用することにおいても可 能であるが、この場合は誘電正接の値も高くしてしまう ので、好ましくない。加えてまた、金属を使用する場合 には温度変化に対する比誘電率の変化量が大きいので適 したものとはいえない。そこで、本発明者は特有の誘電 特質を有し、スチレン系発泡体に混合することによって 比誘電率を高くする作用がある、誘電体セラミックスを 選択することとした。その結果、本発明の誘電発泡成形 品に使用する場合、誘電体セラミックスの混合によっ て、上記課題に示した高い比誘電率、低い誘電正接およ び軽量化の条件を満足させることができることがわかっ

た。

【0009】一方、寸法安定性の面では、ボリスチレン 系樹脂を発泡して得られた成形品は、通常室温での放置 において1年間で-0.6乃至-0.8%の収縮をす る。これに関し、スチレン系樹脂発泡体の成形品では、 その成形品中に含まれている発泡剤及び発泡助剤の量が 少ない場合に、その寸法変化率が小さいことが、漠然と 知られているが、具体的にどの程度の量において、寸法 変化率がどの程度小さくなるかは不明であった。また、 経時の寸法変化の程度を評価するには、長期に渡るテス トが必要であるが、従来は長くても半年乃至1年間の範 囲でのみ、テストが行われており、それ以上長期に渡る データはない。このため、実際に発泡体を長期間(1年 以上)使用する場合には、その寸法の実質変化しないこ とを保証することはできなかった。そこで本発明者は、 鋭意研究し、1) スチレン系樹脂粒子よりなり、かつ上 記誘電体セラミックスが配合された発泡成形品の寸法変 化率と、その成形品に残存している発泡剤量及び発泡助 剤量との相関を明らかにし、これにより改良された寸法 安定性を有する誘電発泡成形品を得ることができること を見出し、さらに

2) 長期に渡る経時寸法変化を簡便的に測定する方法を も検討し、その方法に基づいて上記発泡成形品の経時寸 法変化の範囲を限定することにより、従来にない長期に 渡って高い寸法安定性を保持する誘電発泡成形品が得ら れることを見出した。すなわち、本発明者が判明したと ころの、発泡性スチレン系樹脂粒子から得られる誘電発 泡成形品の寸法変化率と、その成形品に残存している発 泡剤及び発泡助剤の量との密接な関係は、次のとおりで 系樹脂発泡成形品において、発泡成形品に残存している 発泡剤(または、発泡剤および発泡助剤)の量が3重量 %を越えている場合には、その成形品の放置前と比較し て寸法変化率(寸法収縮の程度)は、室温でも1年間で -0.6乃至-0.8%と高い値を示すのに対して、同 発泡剤量が3重量%以下の場合には、-0.3%乃至0 %の低い寸法変化率とすることが可能である。また、本 発明者は、スチレン系樹脂発泡成形品の経時変化の促進 試験により、誘電発泡成形品を50℃のオープン中に約 7

1ヶ月の間放倒した場合における誘電発泡成形品の寸法 変化率の値は、同じ誘電発泡成形品を室温で1年間放置 した場合における発泡成形品の寸法変化率の値と実質的 に一致ないし相当するものであることを見出し(後述の 試験例参照)、よって室温で3年間放置した場合におけ る誘電発泡成形品の経時的寸法変化の程度は、該誘電発 泡成形品を50℃のオーブン中で100日間放置した場 合における寸法変化率の実測値を以って置き換えて評価 することができるとの結論を得た。従って、本発明にお いて目的とする発泡成形品を得るには、発泡剤の含有量 10 の低減等により50℃のオープン中で100日間放置し たときの寸法変化率が放置前と比較して一0.5%乃至 0%となるような寸法安定性を有するものであればよ い。この促進試験に従うと、成形品中の発泡剤量が3重 量%を越えている場合には、−1.2%以上の収縮がみ られたのに対し3重量%以下では-0.4%以下の僅か な収縮がみられたにすぎなかった。以上の検討に基づい て、本発明者は、スチレン系樹脂をペースとした基材樹 脂よりなる寸法安定性な誘電発泡成形品を得るため、発 泡剤量をある特定の範囲に調節し、また基材樹脂に混合 20 する高誘電体材料としてセラミックスを選択して、特定 の割合で上記樹脂と混合して複合材料を作製することに より、球状型誘電体レンズの用途に適した新規な誘電発 泡成形品を発明するに至ったのである。

[0010]

【課題を解決するための手段】従って本発明は、スチレ ン系基材樹脂よりなる発泡体に誘電体セラミックスが実 質的に均一に分散されている誘電発泡成形品であって、 該発泡成形品の比誘電率は1.0乃至2.0の範囲の値 を有し、誘電正接は0.005以下の値を示し、そして 30 協比重は0.3万至0.04g/cm'の値であり、さ らに該発泡成形品に残存している発泡剤(または発泡剤 および発泡助剤)の量が3重量%以下であり、かつ、該 発泡成形品を50℃のオーブン中に100日間放置した ときの該発泡成形品の寸法変化率は、放置前と比較して -0.5%乃至0%であることを特徴とする寸法安定性 を有する誘電発泡成形品に関する。ここで好ましい前記 発泡剤はペンタンまたはブタンである。さらに本発明は 好ましくは、低分子量のポリオレフィン樹脂を前記スチ レン系基材樹脂の総量に基づいて0.1乃至10重量部 40 含むことを特徴とする前記誘電発泡成形品である。前記 低分子量のボリオレフィン樹脂は、重量平均分子量50 0乃至1000の低分子量ポリエチレンであって、融 点が100乃至130℃であることが好ましい。また上 記発泡体に分散された前記誘電体セラミックスは好まし くは主に粉末状またはウィスカー状のものより成り、か つ、該誘電体セラミックスの含有量は前記スチレン系基 材樹脂および該誘電体セラミックスの合計量に基づいて 5乃至50重量%である。なお本明細書では、スチレン 系樹脂、ならびにスチレン系樹脂ブレンドまたは共竄合 50

体の如き、主要な樹脂成分(基材樹脂)のみならず、それと発泡剤以外の他の各種添加剤、改質剤並びに助剤をその成分として必要に応じて含むものを「スチレン系基 材樹脂」と記載する。

8

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の誘電発泡成形品に使用す る誘電体セラミックスとしては、チタン酸バリウム、チ タン酸カルシウム、チタン酸マグネシウム、チタン酸ス トロンチウム、チタン酸鉛等があり、これらを単独でま たは適宜混合して用いることができる。これらのセラミ ックスは粉末状またはウィスカー状で添加される。通常 セラミックス粉末は分散性および造粒の際の取扱い易さ を考慮して平均粒径10μm以下のものを使用するのが 好ましい。またウィスカーでは繊維径 $0.1\sim10\mu$ m、および長さ1~100μm程度の範囲のものが使用 できる。この誘電体セラミックスは、誘電発泡成形品中 におけるスチレン系基材樹脂と誘電体セラミックスの合 計量に基いて5乃至50重量%、好ましくは20乃至4 0 重量%であることが望ましい。セラミックスが誘電発 泡成形品中におけるスチレン系基材樹脂と誘電体セラミ ックスの合計量に基いて50重量%を越えて添加される と、発泡が困難となるため、得られた発泡体は所望する 密度が得られない他、該発泡体の物性も脆いものとなる ので使用に耐えられない。また反対に、セラミックスへ の添加が5重量%以下では、発泡体に対する比誘電率の 向上効果があまりなく、従ってその嵩比重を小さくする ことができない。従って、本発明の好ましい態様は上記 発泡体に分散された前記誘電体セラミックスは好ましく は主に粉末状またはウィスカー状のものより成り、か つ、該誘電体セラミックスの含有量は前記スチレン系基 材樹脂および該誘電体セラミックスの合計量に基づいて 5万至50重量%である上記誘電発泡成形品である。 【0012】本発明で使用する(揮発性)発泡剤として は、例えばプロパン、ブタン、n-ペンタン、イソペン タン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、または、塩化メチ ル、フレオン等のハロゲン化炭化水索が利用される。こ れら揮発性発泡剤は、単独で使用してもよく、また二種 以上の組合せで使用してもよい。しかしながら、環境破 壊の要因となりにくい脂肪族炭化水素が好ましく用いら れる。また、発泡成形品とした場合の発泡剤残留量が少 ないといった点から、ブタンまたはペンタンがより好ま しく用いられ、中でもペンタンが最も好ましく用いられ る。なお、ブロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘ プタン、およびこれらの異性体等の脂肪族炭化水素を単 独または混合使用する場合には、トルエン、キシレンあ るいはエチルベンゼン等の芳香族炭化水素や、酢酸ブチ ル等のエステル類等、公知慣用の溶剤を発泡助剤として 少量併用することもできる。本発明の寸法安定性を有す る誘電発泡成形品の原料であるスチレン系基材樹脂にお

いて添加される、発泡剤及び発泡助剤の合計量(以下、

Q

発泡剤量と略記することもある)は、該誘電発泡成形品 に残存している発泡剤の量を3重量%以下とするため、 従来の一般的な発泡成形品の基材樹脂に添加される量よ りもより少ない鼠であることが望ましい。従って、その 量は、スチレン系基材樹脂粒子の重量に対して、通常1 乃至6重量部の範囲となるであろう。より少量が好適で ある観点より、発泡剤量は好ましくは、1乃至4. 5重 盤部、さらに好ましくは1万至3.5重量部程度であ る。発泡性スチレン系樹脂粒子の予備発泡後の熟成時間 を通常の範囲(8時間乃至1日)に設定するときであっ 10 て、一般的な発泡性スチレン系樹脂粒子を使用する場合 において、発泡成形品中の、発泡剤の量または発泡剤及 び発泡助剤の総量を3重量%以下に抑えるためには、加 える発泡剤量は一般に該発泡性スチレン系樹脂粒子の重 量に対して3.5重量%以下に設定することが通常必要 とされる。しかし、3.5重量%以下の発泡剤量を使用 するときは、比較的高い発泡倍率にて目的とする嵩比重 0. 3乃至0. 04g/cm³の発泡成形品を得る場合 には、その発泡時間が非常に長くなり実際的ではない。 そこで、試みに、基材となるスチレン系樹脂に低分子量 20 のポリオレフィン樹脂を混入した。その結果、この低分 子量のボリオレフィン樹脂は、低い発泡剤量でも所望の 発泡倍率の発泡成形品を得ることを可能ならしめる作用 を有すると同時に、発泡樹脂粒子より発泡剤を効率良く 逸散させる作用を有することが見出されたことから、寸 法安定性の改良に多大に寄与することが明らかとなっ た。この低分子量のボリオレフィン樹脂を前記スチレン 系基材樹脂の総量に基づいて0.1乃至10重量部添加 すると、3.5重量%以下の低い発泡剤量の発泡性スチ レン系樹脂でも所望する発泡倍率の発泡成形品を得るこ とが可能となり、さらには、予備発泡後の予備発泡粒子 から速やかに発泡剤が逸散するので、一般的な熟成時間 内で発泡剤量が3.0重量%以下である発泡成形品が得 られる。この低分子量のボリオレフィン樹脂としては、 低分子量ボリプロピレン、ボリエチレンまたはこれらの 混合物が可能であるが特に、重量平均分子量500乃至 10000で、融点が100乃至130℃である低分子 量ボリエチレンが好ましい。この低分子量のボリオレフ ィン樹脂の添加量は、スチレン系基材樹脂の合計量に基 づいて0.1重量部乃至10重量部、例えば0.5重量 部乃至10重量部、好ましくは0. 3重量部乃至3重量 部用いられる。0. 1 重量部以下の添加量では、上記低 分子量のボリオレフィン樹脂混合の効果は所期通り得ら れず、また10重量部を越えて添加されると、成形品の 融着が極端に低下することから好ましくない。従って本 発明の好ましい態様は、低分子量のポリオレフィン樹 脂、好ましくは、その重量平均分子量が500乃至10 000であり、およびその融点が100乃至130℃で ある、低分子量ポリエチレン樹脂を、スチレン系基材樹 脂の総量に基づいて0.1乃至10重量部含むことを特 50 徴とする上記誘電発泡成形品である。

10

【0013】本発明の寸法安定性を有する誘電発泡成形 品における基材樹脂となるスチレン系樹脂には、スチレ ン系単量体の単独重合体に限らず、他の単量体との共重 合体(スチレン系単量体を50重量%以上の割合で使用 して作られる。)が含まれる。スチレン系単量体には、 単独のスチレンの他に、αーメチルスチレン、エチルス チレン、p-クロロスチレン等の置換スチレンが含まれ る。また、共重合体の相手方の単量体には、メチルメタ クリレート、メチルアクリレート、プチルメタクリレー ト、プチルアクリレート等の(メタ)アクリレート、並 びに、アクリロニトリル、ビニルトルエン、ビニルカル バゾール等のビニル系単量体などが挙げられる。これら は単独で用いてもよく、2種以上のものを併用してもよ い。従って、本発明に用いるスチレン系樹脂としては、 ポリスチレンの他、ポリα-メチルスチレン、ポリp-クロロスチレン等のポリ置換スチレンの他、スチレンと 懺換スチレン(例えばα-メチルスチレン等)との共重 合体、あるいは、スチレンとビニル系単量体(例えばア クリロニトリル)との共重合体などが挙げられる。より 好ましいスチレン系樹脂としては、ボリスチレン、ボリ スチレンープタジエン共重合体、ポリスチレンー無水マ レイン酸共重合体、ボリスチレン-アクリロニトリル共 重合体、スチレンのグラフト共重合体などが挙げられ、 また、スチレンーマレイミド誘導体との共重合体、スチ レンーアクリル酸エステル共重合体、スチレンーメタク リル酸エステル共重合体、スチレン-アクリルまたはメ タクリル酸共重合体等のスチレン共重合体から選択する ことも可能である。さらに好ましいのは、α-メチルス チレンースチレン共重合体、αーメチルスチレンーアク リロニトリル共重合体、スチレン-α-メチルスチレン -アクリロニトリルの三元共重合体である。ただし、α メチルスチレン、またはスチレンとα-メチルスチレ ンの合計の量は全樹脂100重量部中の50重量部以上 でなければならない。また、スチレン系樹脂としては、 通常、重量平均分子量150,000万至500,00 0を有する、より好ましくは重量平均分子量200,0 00乃至300,000を有する高分子量のスチレン系 樹脂が使用されるが、部分的に、より低分子量のスチレ ン系樹脂をブレンドすることも可能である。特に、上記 低分子量のポリオレフィンの添加に加えて、スチレン系 基材樹脂に低分子量スチレン樹脂を添加すると、低分子 鼠のボリオレフィンの添加と相乗的に発泡倍率を向上す る作用、発泡粒子から発泡剤を逸散させる作用があるこ とが判った。また、低分子量スチレン樹脂の添加を上記 低分子量のボリオレフィンの添加に置換えてもよい。低 分子型スチレン樹脂を用いることで、3.5重量%以下 の低い発泡剤量の発泡スチレン系樹脂粒子でも所望の発 泡倍率の発泡成形品が得られるのであり、さらには予備

発泡の後、予備発泡粒子から速やかに発泡剤が逸散する

ので、一般的な熟成時間内で発泡剤量が3.0重量%以下になるのである。この低分子量スチレン樹脂としては重量平均分子量500乃至10000、好ましくは5000乃至10000のものが使用される。この低分子量スチレン樹脂の添加量は基材樹脂であるスチレン系樹脂の総量に基づいて1乃至30重量部、好ましくは3乃至10重量部用いられる。1重量部以下では上記した添加の効果がほとんど見られず、また30重量部を越えて添加されると、発泡成形品の強度が極端に低下するので好ましくない。またスチレン系樹脂には上記ボリオレ10フィン樹脂の他、例えばボリフェニレンエーテル系樹脂等の他の樹脂が50重量%以下の量でブレンドされたものも含まれる。

【0014】また、上記のスチレン系樹脂には、懸濁重 合により新規に合成されたスチレン系樹脂に限られず、 スチレン系樹脂発泡体などの再利用(リサイクル)化に よって再生されたスチレン系樹脂が適用される。再生さ れたスチレン系樹脂を発泡性スチレン系樹脂粒子の原料 に用いることは、資源の再利用および環境保護の面から も好ましいことである。従って、近年では、再生された 20 スチレン系樹脂の利用が急速に進んでいる。再生された スチレン系樹脂には、市場に流通し使用されたスチレン 系樹脂およびスチレン系樹脂発泡体を回収し、続いて該 発泡体にあっては溶融等によって減容し、次いで、回収 されたスチレン系樹脂を裁断によって細かく粉砕し、そ して、その粉砕物を押出し機内に投入し、押出し成形す ることにより、得られるところのペレット形態のスチレ ン系樹脂粒子(所謂、再生ペレット)が含まれる。ま た、発泡性スチレン系樹脂粒子の生産工場内において、 その製造過程で生じるオフグレードの発泡性スチレン系 30 樹脂粒子、即ち粒径が0.5mm未満もしくは粒径が2 mmを越えスチレン系樹脂発泡体の一般的な用途に適さ ない要求品質外の発泡性スチレン系樹脂粒子を回収し、 これを押出し成形することにより、得られるところの再 生ペレットもまた、再生されたスチレン系樹脂として、 本発明におけるスチレン系基材樹脂に利用することがで きる。

【0015】本発明の寸法安定性を有する誘電発泡成形品に使用するスチレン系基材樹脂中には必要に応じて、他の各種の添加剤、改質剤並びに助剤を適当な量で配合 40 することができる。それらとしては例えば、発泡倍率を向上させる可塑剤(例えばDOP、DOA、DBP、ヤシ油、パーム油、ステアリン酸等)、無機系あるいは有機系の核形成剤(例えばタルク、ベントナイト、エチレンビスステアリン酸アミド、ステアリン酸亜鉛等)、またセル形成剤、着色剤、滑剤、帯電防止剤、難燃剤(例えば、ヘキサブロムシクロドデカン、テトラブロモビスフェノールA、ペンタブロモモノクロルシクロヘキサン等)が挙げられる。これら薬剤は、従来発泡性スチレン系樹脂粒子において利用されているものより適宜選択し 50

て使用され、スチレン系基材樹脂の押出し成形の工程も しくは発泡剤の含浸の工程において添加される。

12

【0016】上記のスチレン系基材樹脂は、一般に水性 媒体中でのスチレン系単量体等の懸濁重合により製造さ れる。これらの懸濁重合はラジカル重合開始剤、分散剤 および分散助剤などを含む水性懸濁系の中で進められ る。ラジカル重合開始剤としては、一般的なラジカル重 合に使用される重合開始剤、例えば、過酸化ベンゾイ ル、過安息香酸ブチル、tーブチルパーオキシベンゾエ ート等の有機過酸化物、あるいはアゾビスイソブチロニ トリル等のアゾ化合物が挙げられる。また、使用される 分散剤としては、例えば、リン酸三カルシウム、リン酸 マグネシウム、ハイドロキシアパタイト等の難水溶性の 無機塩、またはボリビニルアルコール、ポリビニルピロ リドン、メチルセルロース等の有機高分子化合物が挙げ られる。さらに、上記分散剤と組合せて使用される分散 助剤としては、ドデシルフェニルオキサイドジスルホン 酸塩、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、α-オ レフィンスルホン酸ナトリウム等のアニオン系界面活性 剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシ エチレンオクチルフェノールエーテル等のノニオン系界 面活性剤があげられる。

【0017】発泡剤を既に含んでいるオフグレードの発泡性スチレン系樹脂粒子を原料として用いた場合を除いて、通常はスチレン系樹脂粒子に対する発泡剤の含浸処理が為される。従って、上述の懸濁重合されたスチレン系基材樹脂は押出し成形により粒子形態またはペレット形態にし、発泡剤をそれに含浸させることによって発泡性スチレン系樹脂粒子を製造する。

[0018] しかし、本発明では、上記スチレン系基材 樹脂に誘電体セラミックスを均一に含有させなくてはな らない。このためスチレン系基材樹脂の懸濁重合系に誘 電体セラミックスを多量に添加することが考えられる が、これによって該重合系が著しく不安定になることか ら、誘電体セラミックスは押出機において混合すること が望ましい。従って、その方法としては、

(A) スチレン系基材樹脂、及び所望により低分子量ボリオレフィン並びに高誘電体セラミックスを押出機で混練し、これらが均一に混合されたセラミックス入りスチレン系樹脂ペレットを得る。この基材樹脂ペレットを懸濁系に移し分散させた後、発泡剤を含浸して高誘電体セラミックスが均一に入った発泡性スチレン系樹脂粒子を得る方法;

(B) 発泡性スチレン系基材樹脂粒子と高誘電体セラミックスを押出機内で混練り押出して、高誘電体セラミックスが均一に入った発泡性スチレン系樹脂ペレットを得る方法;ここにおける発泡性スチレン系基材樹脂粒子を得る方法は、例えば1) 懸濁重合で得た(所望により低分子量ボリオレフィンを含有する)スチレン系基材樹脂粒子または押出機より得た(所望により低分子量ボリオ

レフィンを含有する)スチレン系基材樹脂ペレットを、 懸濁系において発泡剤を含浸する方法か、または2)押 出機内で、(所望により低分子量ポリオレフィンを含有 する) スチレン系基材樹脂とが混練りされた後に、押出 機内に発泡剤を添加しスチレン系基材樹脂に含浸し、発 泡性ペレットとして得る方法である;

(C) 押出機における、(所望により低分子量ポリオレ フィンを含有する) スチレン系基材樹脂と高誘電体セラ ミックスとの混練り後に、押出機内に発泡剤を添加しス チレン系基材樹脂に含浸して押出すことにより、高誘電 10 体セラミックスが均一に入った発泡性スチレン系樹脂ペ レットを得る方法: 等がある。

【0019】而して、作られた高誘電体セラミックスが 均一に入った発泡性スチレン系樹脂粒子又はペレット は、通常、ドライヤーなどを用いた乾燥処理を十分に行 なった後、篩分け機で所定の粒子径のものに分別され、 次いで、例えば滑剤、帯電防止剤などのブレンド剤を分 別された発泡性スチレン系樹脂樹脂粒子又はペレットに 混合され、その後、ドラム缶等の中に密封、梱包され る。しかして、保管された前記発泡性スチレン系樹脂粒 20 子又はペレットを必要により任意の見かけ比重にまで予 備発泡し、次いで、常法に従い、予備発泡粒子を金型等 の成形型内に充填し、そして蒸気を用いて加熱発泡する ことにより、予備発泡粒子を相互に融着させて、所望の 形状(寸法)の寸法安定性を有する発泡成形品(発泡 体)を作ることができる。

【0020】本発明に係るスチレン系基材樹脂よりなる 発泡体に誘電体セラミックスが実質的に均一に分散され ている誘電発泡成形品は、上記課題である、「長期に渡 る寸法安定性に優れかつ比誘電率の温度依存性が小さ い、比誘電率が1.0乃至2.0の範囲内において誘電 正接が0.005以下である; 嵩比重が0.3乃至0. 04g/cm³と極めて軽量である誘電体材料」として の条件を全て満たす優れた発泡成形品である。従って、 本発明の誘電発泡成形品は特に上記条件が要求されると ころの球状型誘電体レンズ、例えばルーネベルクレンズ の原理を利用したものを備えたレーダー電波反射器用の またはアンテナ用の誘電体材料として使用できる。加え て、本発明はさらに下記実施例より類推されるように、 協比重0.25g/cm³付近においても、比誘電率が 2. 0以上でかつ、誘電正接が0. 005以下の誘電体 材料を提供でき、この性質を利用して球状型誘電体レン ズ以外のアンテナ、レーダー電波反射器等のための誘電 体材料として、また2.0を越える比誘電率が要求され る他の用途における誘電体材料として慣用のさまざまな 用途に使用できる。なお、本明細書中に記載する比誘電 率及び誘電正接の値は、板状試料を使用する空洞共振法 によって測定することができる。即ち、空洞共振器に厚 さdの試料を挿入し、軸長変化法で同調をとり、つぎ に、被測定試料を除去し、再び軸長変化法により同調さ 50

せ、両者の軸長の差sを測定する。得られたs値とd値 とを所定の計算式に当てはめることにより比誘電率及び 誘電正接は算出される(鈴木桂二著、「マイクロ波測 定」、高周波計測全書No.4、コロナ社刊、第3版、19 61年、180頁~205頁)。

[0021]

【実施例】本発明を以下の実施例でさらに詳細に説明す るが、これらの実施例は本発明を限定することを目的と するものではない。

【0022】まず、寸法変化率の経時における評価の基 準を作成するため、スチレン系樹脂発泡成形品について 以下の試験を行った

試験例

ファドラー型撹拌機付きの内容量5Lのオートクレーブ に、イオン交換水1800grを投入し、リン酸三石灰 5. 4gr、ドデシルペンゼンスルホン酸ナトリウムを 0.05grを加えて良く混合撹拌した。その系に、ス チレンモノマー1800gr (100重量部)、重合期 始剤として過酸化ベンゾイル5. 4gr、t-ブチルパ ーオキシベンゾエート1.8gr、を添加し撹拌を行い ながら、90℃まで昇温し、5時間保持して重合を進行 させてポリスチレン粒子を生成した。重合の終了の後 に、発泡剤のn-ペンタンを下記の表-1に示される量 でオートクレーブ内に圧入し、その系を120℃にまで 昇温して6時間保持することで発泡剤をボリスチレン粒 子に含浸せしめた。この処理の後、重合反応系を室温ま で冷却し、生成した発泡性スチレン系樹脂粒子を容器よ り取り出し、粒子表面に付着しているリン酸三石灰を酸 洗浄して取り除いた。この後、遠心分離ないし乾燥工程 を経て粒子表面の付着水を除き、篩い分けにより、粒径 0. 7乃至1. 0mmの粒子を分別して得た。この粒子 を室温で5日間熟成させた後、101℃の水蒸気により 嵩倍率10倍(嵩比重0.1)にまで予備発泡を行っ た。また、得られた予備発泡粒子は、室温にて24時間 熟成した後、自動成形機の成形型内に投入し、圧力(ゲ ージ圧力) 0.7Kg/cm'にて8秒間加熱した後、 金型を水冷及び放冷して作られた30×30×5cmの 発泡成形品を取りだし、寸法測定用の試料とした。

【0023】成形品中に含まれる発泡剤量は成形後、1 日目の発泡成形品の一部を取り、その重量を測定し、次 いでそれを150℃のオープン中で1時間保持し、その 後再びその重量を測定し、それぞれの重量値を下記「式 -1] に導入することにより求めた。また、成形前の発 泡性スチレン系樹脂粒子中に含まれる発泡剤量も同様 に、予備発泡前の上記発泡性スチレン系樹脂粒子の一部 を取って重量測定して得た値とそれを150℃のオーブ ン中で1時間保持し、その後再び重量を測定して得た値 から [式-1] に従って求めた。

【数1】

15

発泡剤量= (加熱前の重量-150℃オーブン中で1時間保持後の重量) 加熱前の重量

[式-1]

16

これらの結果を表-1に示した。

(表-1)

【表1】

| 番号 | 仕込み ペンタン 量 (gr) | スチレンモノマー に対するペンタン の添加量 (重量部) | 樹脂粒子中の 発泡剤量 (重量%) | 発泡成形品中 の発泡剤量 (重量%) | |
|-------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 試験例-1 | 4 3 | 2. 4 | 1. 6 | 1. 2 | |
| 試験例-2 | 9.0 | 5. 0 | 4. 0 | 3. 5 | |

次に、発泡成形品の寸法安定性能を評価するために、発泡成形品中に含まれる発泡剤の量と、該成形品の経時的な寸法変化率の関係を調べた。発泡成形品の経時的な寸法変化率は下記に説明する通り、下記[式-2]ないし[式-4]に従って求めた。上記発泡成形品について、まず、成形後1日目の成形品の金型に対する寸法変化率を、下記[式-2]に基づいて算出し、この値を放置前の基準値とした。室温放置における発泡成形品の寸法変化 20

率は、下記[式-3]に従って、室温で所定日数放置した時点における金型に対する寸法変化率と上記基準値との差より求めた。また、50℃オーブン中に放置したときの発泡成形品の寸法変化率は、下記[式-4]に従って、50℃オーブン中で所定日数放置した時点における金型に対する寸法変化率と上記基準値との差より求めた。 【数2】

発泡成形品の 金型に対する 寸法変化率

(成形後所定日数の経過時点における発泡成形品寸法 - 金型寸法) 金型寸法

[式-2]

【数3】

室温放置における 寸法支化率 宝温放置における発泡 = 成形品の金型に対する 寸法変化率 成形後1日目の発泡 成形品の金型に対す る寸法変化率

[式-3]

【数4】

50℃オーブン中 に放置したときの 寸法変化率 成形後50℃オーブン中に放 置したときの発泡成形品の会 型に対する寸法変化率 成形後1日目の発泡 成形品の金型に対す る寸法変化率

[式-4]

【0024】試験例-1と試験例-2についての試料の室温放置における発泡成形品の経時の寸法変化率、ならびに50℃オーブン中に放置にしたときの発泡成形品の経時の寸法変化率はグラフにし、それぞれ図1および図2に示した。図1に示すグラフにおいては、発泡成形品中に含まれる発泡剤量が1.2重量%である試験例-1の試料では室温放置おける約1年後の発泡成形品の寸法変化率は-0.2%以下であるが、発泡成形品中に含まれる発泡剤の量が3.5重量%である試験例-2の試料では、発泡成形品の寸法変化率は約-0.7%と非常に大きいことが分かる。図2に示すグラフにおいては、発泡成形品中に含まれる発泡剤量が1.2重量%である試験例-1の試料では、50℃のオーブン中で放置したときの100日目の発泡成形品の寸法変化率は約-0.2%であるが、発泡成形品中に含まれる発泡剤の量が3.

5重量%である試験例-2の試料では、発泡成形品の寸法変化率は約-1%という著しい寸法収縮が見られた。また、図1に示すグラフ及び図2に示すグラフから、50℃オーブン中で放置した場合の約1ヶ月間の発泡成形品の寸法変化率の値は、室温放置における約1年間の発泡成形品の寸法変化率に実質的に一致ないし相当することは明らかである。従って、発泡成形品の50℃オーブン中における100日間放置は、発泡成形品の室温における約3年間の放置に相当すると推定され、このことから50℃オーブン中における100日間放置したときの発泡成形品の寸法変化率の実測値をもって、室温での3年間放置した場合の発泡成形品の経時的寸法変化の程度を評価できる。

【0025】実施例-1

50 ポリスチレン樹脂100重量部、髙誘電体として平均粒

18

径10μm以下のチタン酸パリウム25重量部(20重量%)を押出機内に投入し、これを加熱による溶融そしてスクリューによる混練りに続いて、ストランドの形態にて押出し、その後そのストランドをロータリー式ペレタイザーにおいて切断し、ペレット化した。得られた誘電体を含有したポリスチレン樹脂ペレット1500grを5Lのオートクレーブ中に入れ、さらに、イオン交換水2500gr、分散剤としてリン酸三石灰15grおよびドデシルペンゼンスルホン酸ナトリウム0.15grをオートクレーブ内に投入し、続いて、この混合物を10撹拌しながら、揮発性発泡剤のnーペンタン45gr(樹脂ペレットに対して3重量%)を圧入した。次いで、オートクレーブ内の水性懸濁系を130℃に昇温し、その状態を8時間保持することにより、nーペンタ

17

し、その状態を8時間保持することにより、n-ペンタ ンを樹脂ペレットに含浸せしめた。この処理の後、水性 懸濁系を室温まで冷却し、生成した複合誘電発泡樹脂粒 子を、水洗後遠心分離機により脱水し、ドライヤーで乾 燥後20℃室温で5日間熟成した。この様にして得られ た複合誘電発泡樹脂粒子は、水蒸気により予備発泡を行 い、表-2に示す嵩比重にした。予備発泡粒子を熟成し 20 た後、自動成形機の成形型内に投入して成形し、30× 30×5cmの発泡成形品を得た。この発泡成形品の一 部を50×50×1.0mmに切り出し、前記板状試料 を使用する空洞共振法により12GHzでの比誘電率、 誘電正接($tan\delta$)を測定した。この結果を表-2に 示した。本実施例における発泡樹脂粒子中の発泡剤量 は、予備発泡前の発泡樹脂粒子中の発泡剤量をガスクロ マトグラフィーを用いて定法に従って求めた。また、成 形品中に含まれる発泡剤の量は、成形後、1日目の成形 体の一部を取り、同様に求めた。これらの結果を表-2 30 に示した。また、上記成形品について、[式-2] 乃至 [式-4] に従って、成形後1日目の金型に対する寸法 変化率、50℃オーブン放置後100日目の寸法変化率

【0026】 実施例-2

を調べた。

実施例-1において発泡剤のn-ペンタンの量を60g

r (樹脂ペレットに対して4重量%).にした以外は実施 例-1と同様に行った。

実施例-3

実施例-1において、押出し時に重量平均分子量1000、 脱点が111 $^{\circ}$ のボリエチレンワックスを1 重量部添加した以外は、実施例-1 と同様に行った。

実施例-4

実施例-2において、押出し時に重量平均分子量300 0、融点が128℃のポリエチレンワックスを2重量部 添加した以外は、実施例-1と同様に行った。

実施例-5

既に発泡剤としてn-ペンタンが5重量%入っているスチレン樹脂粒子100重量部と、チタン酸パリウム67部(40重量%)を押出機内に投入し、これを加熱による溶融、そしてスクリューによる混練りに続いて、ストランドの形態にて押出し、その後そのストランドをロータリー式ペレタライザーにおいて切断して、発泡剤が入った複合誘電発泡樹脂ペレットを得た。このペレットを実施例-1と同様に予備発泡ないし成形を行い評価した。

【0027】比較例-1

実施例-1において、高誘電体としてチタン酸バリウム を添加せず、また揮発性発泡剤のn-ベンタンの量を7 5gr(樹脂ペレットに対して5重量%)にした以外は 実施例-1と同様に行った。

比較例-2

実施例-1において、揮発性発泡剤のn-ペンタンの量を75gr(樹脂ペレット5重量%)にした以外は実施例-1と同様に行った。

30 比較例-3

実施例-5において、既に発泡剤としてn-ペンタンが 7重量%入っているスチレン樹脂粒子を用いた以外は、 実施例-5と同様に行った。

【0028】結果を表-2にまとめる。

【表2】

19 (表-2)

| (25 82) | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------|--------|---|---|
| ロット | 嵩比重 (g/cm³) | 樹脂粒子 中の発泡 剤量 (重量%) | 成形品中 の発泡剤 量 (重量%) | 比誘電率 | 静電正接 | 成形後 1日目の 金型に対 する寸法 変化率 (%) | 50℃オープ ン放置後 100日目に おける寸法 変化率(%) |
| · 突施例-1 | 0.06 | 2.2 | 1.7 | 1.25 | 0.0011 | - 0.52 | - 0.23 |
| | 0.19 | · | 1.8 | 1.83 | 0.0013 | - 0.53 | - 0.26 |
| | 0.23 | | 1.8 | 1.97 | 0.0015 | - 0.51 | - 0.25 |
| 実施例-2 | 0.06 | 3.2 | 2.7 | 1.24 | 0.0012 | - 0.41 | - 0.38 |
| | 0.15 | | 2.8 | 1.61 | 0.0012 | - 0.44 | - 0.35 |
| | 0.22 | | 2.8 | 1.95 | 0.0014 | - 0.42 | - 0.36 |
| 奖施例-3 | 0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.22 | 0.0011 | - 0.54 | - 0.17 |
| | 0.15 | | 1.3 | 1.63 | 0.0012 | - 0.54 | - 0.18 |
| | 0.23 | | 1.3 | 1.98 | 0.0014 | - 0.54 | - 0.17 |
| 実施例-4 | 0.05 | 3.1 | 2.0 | 1.21 | 0.0011 | - 0.45 | - 0.28 |
| | 0.16 | | 2.0 | 1.67 | 0.0013 | - 0.44 | - 0.28 |
| | 0.22 | | 2.0 | 1.96 | 0.0014 | - 0.44 | - 0.29 |
| 実施例-5 | 0.05 | 2.8 | 2.2 | 1.29 | 0.0024 | - 0.44 | - 0.30 |
| | 0.13 | | 2.2 | 1.75 | 0.0026 | - 0.44 | - 0.29 |
| | 0.16 | | 2.3 | 1.96 | 0.0027 | - 0.44 | - 0.30 |
| 比較例-1 | 0.05 | 4.3 | 3.9 | 1.10 | 0.0001 | - 0.15 | - 1.21 |
| | 0.16 | | 3.9 | 1.21 | 0.0001 | - 0.15 | - 1.25 |
| | 0.27 | | 4.0 | 1.33 | 0.0001 | - 0.16 | - 1.22 |
| | 0.42 | | 4.0 | 1.51 | 0.0002 | - 0.17 | - 1.24 |
| 比較例-2 | 0.05 | 4.2 | 3.6 | 1,22 | 0.0011 | - 0.25 | - 1.11 |
| | 0.18 | | 3.7 | 1.73 | 0.0013 | - 0.24 | - 1.13 |
| | 0.22 | | 3.7 | 1.94 | 0.0014 | - 0.27 | - 1.10 |
| 比較例-3 | 0.05 | 4.0 | 3.5 | 1.32 | 0.0023 | - 0.28 | - 1.01 |
| | 0.14 | | 3.5 | 1.85 | 0.0026 | - 0.27 | - 1.00 |
| | 0.17 | | 3.5 | 2.00 | 0.0028 | - 0.29 | - 1.03 |

成形後1日目の発泡成形品の金型に対する寸法変化率は 仮に大きくても、その変化率を予め金型設計の段階で考 慮して行えば良いことから、特に問題にはならない。こ れに対し、経時の寸法変化率は、できるだけ少ない値で あることが望ましい。

- 1) 実施例-1は、成形品中の発泡剤量が、1.7重量 %乃至1.8重量%であるが、成形後1日目に測定した 寸法変化率はやや大きいが、50℃オーブン中放置後1 00日目の寸法変化率は、いずれも-0.3%以下と少 なかった。また、比誘電率は嵩比重0.23g/c㎡ において、ほぼ2.0の値を得ることができ、誘電正接 も小さい値であった。
- 2) 実施例-2は、成形品中の発泡剤量が2. 7重量% 乃至2.8重量%であるが、成形後1日目に測定した寸 法変化率はやや大きいが、50℃オーブン中放置後10 40 0日目の寸法変化率は、いずれも-0.4%以下と少な かった。また、比誘電率は嵩比重0.22g/cm²に おいて、ほぼ2.0の値を得ることができ、誘電正接も 小さい値であった。
- 3) 実施例-3は、押出時に低分子量ポリエチレンワッ クスを添加した系であるが、発泡樹脂粒子の発泡剤量が 実施例-1と同じ2.2重量%であるのに対して、成形 品中の発泡剤量は1.3重量%と少なくなっていた。こ れは低分子量ポリエチレンワックスの添加により、予備 発泡ないし成形の間において、効率良く発泡剤が逸散し 50 法変化率は、いずれも-0.3%以下と少なかった。

ていることが分かる。成形後1日目に測定した寸法変化 率はやや大きいが、50℃オーブン中放置後100日目 の寸法変化率は、いずれも-0.2%以下と少なかっ た。また、比誘電率は湖比重 0.23 g/c m³ におい て、ほぼ2.0の値を得ることができ、誘電正接も小さ い値であった。

- 4) 実施例-4は、押出時に低分子量ポリエチレンワッ クスを添加した系であるが、発泡樹脂粒子中の発泡剤量 が実施例-2とほぼ同じ3.10風景%であるのに対し て、成形品中の発泡剤量は2.0重量%と少なくなって いた。これは低分子量ポリエチレンワックスの添加によ り、予備発泡ないし成形の間において効率良く発泡剤が 逸散していることが分かる。成形後1日目に測定した寸 法変化率はやや大きいが、50℃オープン中放置後10 0日目の寸法変化率はいずれも-0.3%以下と少なか った。また、比誘電率は嵩比重0.22g/cm にお いて、ほぼ2.0の値を得ることができ、誘電正接も小 さい値であった。
- 5) 実施例-5は、高誘電体の量を増加した例である が、比誘電率は嵩比重0.16g/cm において、ほ ば2. 0の値を得ることができ、誘電正接も小さい値で あった。成形品中の発泡剤量は2. 2 重量%乃至2. 3 重量%であるが、成形後1日目に測定した寸法変化率は やや大きいが、50℃オーブン中放置後100日目の寸

6)比較例-1は、高誘電材料を添加せず、発泡剤を多く含浸した例であるが、成形品中の発泡剤量が3.9重量%乃至4.0重量%であるが、成形後1日目に測定した寸法変化率は少ないものの、50℃オーブン中放置後100日目の寸法変化率は、いずれも-1.2%を越えた大きい値であった。また、比誘電率は嵩比重0.42g/cm³においても、1.51と小さい値であり、

1. 6以上の値を低密度で得ることはできなかった。

7)比較例-2は、実施例-1に対して発泡剤を多く含 浸した例であるが、比誘電率は嵩比重0.22g/cm 10 において、ほぼ2.0の値を得ることができたものの、成形品中の発泡剤量が3.6 重量%乃至3.7 重量%と高いため、成形後1日目に測定した寸法変化率は少ないものの、50℃オーブン中放置後100日目の寸法変化率は、いずれも-1.1%を越えた大きい値であった。

8)比較例-3は、実施例-5に対して発泡剤を多く含有した発泡スチレン樹脂から押出した例であるが、比誘電率は高比重0.17g/cm'において、ほぼ2.0の値を得ることができたものの、成形品中の発泡剤量が203.5重量%と高いため、成形後1日目測定した寸法変化率は少ないものの、50℃オープン中放置後100日目の寸法変化率は、いずれも-1.0%を越えた大きい値であった。

[0029]

【発明の効果】以上に述べたように本発明により、誘電発力成形品についてきわめて高い経時寸法安定性が達成

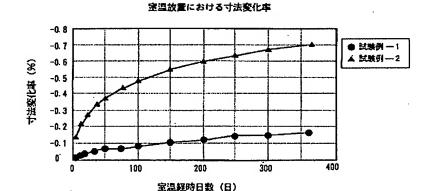
され、従って長期に渡って温度変化に対する比誘電率の 変化量が小さく、また比誘電率が1.0乃至2.0の範 囲内において誘電正接が0.005以下であり、満比重 3乃至0.04g/cm³の軽量で大変優れた誘電 発泡成形品を提供することができる。本発明の誘電発泡 成形品は室温で3年間放置した場合において、寸法変化 率-0.5%乃至0%のきわめて高い寸法安定性を有す る成形品である。従って、この誘電発泡体は特に、ルー ネベルクレンズの原理を利用した球状型誘電体レンズの ような屋外で使用する誘電体材料に適する。また、本発 明はさらに、高く長期に渡って安定した寸法安定性を有 しつつ、協比重0.25g/cm²付近においても、比 誘電率が2.0以上でかつ、誘電正接が0.005以下 の誘電体材料を提供することができ、この性質を利用し て球状型誘電体レンズ以外のアンテナ、レーダー電波反 射器等のための誘電体材料として、また2.0を越える 高い比誘電率が要求される用途における誘電体材料とし て慣用のさまざまな用途に使用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は1年間室温放置したときの、試験例-1 と試験例-2の発泡成形品について、室温経時日数と各 々の寸法変化率との関係を示すグラフである。

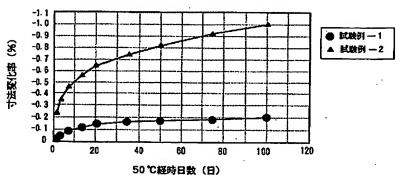
【図2】図2は50℃のオーブン中に100日間放置したときの、試験例-1と試験例-2の発泡成形品について50℃経時日数と各々の寸法変化率との関係を示すグラフである。

[図1]



[図2]

50℃オープン中放置における寸法変化率



フロントページの続き

(51) [nt.Cl.²

識別記号

FΙ H 0 1 B 3/44 テーマコード(参考)

H 0 1 B 3/44

Fターム(参考) 4F074 AA16 AA17 AA24 AA32 AC22

AC23 BA36 BA37 BA39 BA40

BA44 BA53 CA21 CA23 CA31

CA34 CA38 CA49 DA02 DA22

DA47 DA59

4J002 BB022 BB122 BC021 DE186

FD320

5G303 AA04 AA10 AB06 AB07 AB20

BA11 CA01 CA09 CB03 CB06

CB17 CB25 CB32 CB35

5G305 AA09 AA20 AB09 AB10 AB27

BA14 CA02 CB28 CC11 CD04

THIS PAGE BLANK (USPTO)